PCT

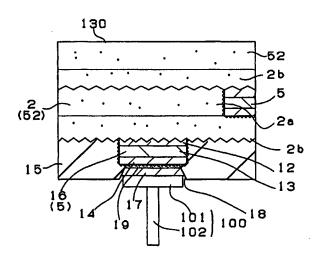
世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類7 H05K 1/11		A1	`	 国際公開番号 国際公開日 	WO00/36886 2000年6月22日(22.06.00)
(21) 国際出願番号 (22) 国際出願日 (30) 優先権データ 特願平10/357039 特願平11/34616 特願平11/97648 特願平11/97649 特願平11/97650 特願平11/104294 特願平11/231931 特願平11/231932 特願平11/231933 特願平11/231933	PCT/JI 1999年11月17日 1998年12月16日(16.12.98 1999年1月4日(04.01.99) 1999年4月5日(05.04.99) 1999年4月5日(05.04.99) 1999年4月12日(12.04.99) 1999年8月18日(18.08.99) 1999年8月18日(18.08.99) 1999年8月18日(18.08.99))		(75) 発明者/出願人(米国につ	P] IP] P/JP] 町北方1丁目1番地 「Gifu, (JP) 905番地 Gifu, (JP) , Akihito et al.)
(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) イビデン株式会社(IBIDEN CO., LTD.)[JP/JP] 〒503-0917 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地 Gifu, (JP)				(81) 指定国 KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE) 添付公開書類 国際調査報告書	

(54) Title: CONDUCTIVE CONNECTING PIN AND PACKAGE BOARD

(54)発明の名称 導電性接続ピン及びパッケージ基板



(57) Abstract

On the board provided with a conductive layer (5), a pad (16) is formed to fix a conductive connecting pin (100) on a package board (310). The conduction connecting pin (100) serves as electrical connection to a motherboard. The pad (16) is coated with an organic-resin insulating layer (15) having an opening section (18) from which the pad (16) is partially exposed. The conductive connecting pin (100) is fixed to the pad exposed from the opening section using a conductive adhesive (17), preventing the conductive connecting pin (100) from separating off the board at the time of mounting.